股票简称:汇成股份　　股票代码:688403

合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

Union Semiconductor(Hefei)Co., Ltd.

(合肥市新站区合肥综合保税区内)

保荐机构(主承销商)

海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路689号)

二〇二四年八月

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说明书正文全文,并特别关注以下重要事项。

一、本符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入科创板后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条款,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,有条件赎回价格为债券面值加当期应计利息。如股东公司可转换债券持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债赎回时触发了,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款,包括有条件回售条款和附加回售条款,回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在满足回售条款的前提下,公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司,公司将面临较大可转换公司债券回售现付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

三、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具的信用评级报告,发行人主体信用评级为AA-,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用评级为AA-。

本次发行的可转换公司债券上市后,在债券存续期内,中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

四、本次发行不提供担保

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。

五、特别风险提示

本公司提醒投资者仔细阅读募集说明书全文,并特别注意以下风险:

(一)市场竞争加剧及公司综合竞争力相对行业头部企业较小的风险

近年来,集成电路封装测试行业竞争日趋激烈,显示驱动芯片封测领域竞争不断减少,一方面,境内行业龙头企业不断拓展产品线,如通富微电2017年立项研究12寸晶圆金凸块制造技术,进军显示驱动芯片封测领域;另一方面,外资与台资封装测试企业进一步布局中国境内市场,如英特阳光达科技股份有限公司与日月光半导体(昆山)有限公司合作的“芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目”已经成功实现量产。

相比显示驱动芯片封测行业头部企业颀邦科技、南茂科技等,公司业务规模仍存在较大差距。公司起步较晚、受资金、规模等方面的限制,综合竞争力亟待提升。在业务快速扩张的过程中,如果公司不能保持应对同行业龙头企业竞争中的规模优势,将可能导致公司业务发展受阻;此外,境内外龙头企业的双重竞争态势愈发激烈,市场竞争加剧的风险可能使公司的经营受到一定冲击。

(二)区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对封材料和设备有较高要求,对行业人员在图向管生产设备和国产原材料应用中国境内(以公司为主)、台湾地区、韩国等地区的供应商有较高要求,公司主要客户的另增外企业(以中国台湾地区为主)、报告期内,公司对境外客户(以直接客户注册所在地为统计口径)销售金额占主营业务收入的比例在60%以上。

如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化,限制进出口或提高关税,公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形,进而导致公司生产受限、订单减少、单位成本增加,对公司的业务和经营产生不利影响。

(三)毛利率波动及下滑的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为30.63%、30.18%和27.17%,2023年毛利率相较于2022年度有所下降,主要系2022年下半年至2023年第一季度,公司产品终端应用市场消费需求有所下滑,销售单价有所降低,而订单饱和度有所下降,单位固定成本有所上升导致。如果未来呈显示面板产业周期波动影响,或国家产业政策调整,导致显示驱动芯片封测需求持续下滑,公司可能无法获取有效的客户订单形成生产规模效应,以及公司生产及管理能力水平若无法适应未来发展,造成人力成本过高,将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平;或者公司研发未来受限于资金规模,不能持续有效地实施业务发展规划,保持技术与服务的领先性,提供高附加值服务,均可能导致公司毛利率面临进一步下滑的风险。

(四)客户集中度较高的风险

报告期内,公司对前五大客户的主营业务收入合计分别为56,284.51万元、70,531.76万元和89,078.70万元,占当期主营业务收入的比例分别为74.40%、70.76%和70.24%,客户集中度较高。如果未来公司的主要客户生产经营出现问题,导致其向公司下达的订单数量下降,或公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模,无法有效开拓新的客户资源,将可能对公司经营业绩产生不利影响。

(五)供应商集中度较高的风险

报告期内,公司向前五大原材料供应商采购额合计为28,053.50万元、30,939.63万元和29,983.89万元,占当期原材料采购总额的比例为53.79%、53.07%和50.32%,供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化,或公司能力不能满足公司生产需求,或与公司业务关系发生变化,公司在短期内可能面临原材料短缺,从而对公司的生产经营产生不利影响。

(六)公司经营模式及销售模式存在变化的风险

公司所处行业为晶圆制造和封测行业,固定资产投入规模较大,公司实现规模效应的关键因素之一为通过提升产能利用率以摊销固定成本,因此公司在业务开拓方面,以及公司生产及管理能力水平若无法适应未来发展,或公司未能成功实现规模效应,公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形,进而导致公司经营业绩产生不利影响。

(七)公司业绩下滑的风险

报告期内,公司实现营业收入分别为56,284.51万元、70,531.76万元和89,078.70万元,呈现逐年上升的趋势,但公司未来经营业绩仍受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争格局等因素影响,公司业绩存在下滑的风险。

(八)本次募集资金投资项目未达预期效益的风险

本次募集资金投资于晶圆测试产能扩充项目、封测产能扩充项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目,上述募集资金投资项目经公司内部充分论证,是公司根据国家产业政策、行业发展趋势等因素作出的决策,有利于公司进一步巩固公司在显示驱动芯片封测领域的竞争优势,提升公司盈利能力和市场竞争力,符合公司发展战略。但在募集资金投资项目实施过程中,如果公司未能顺利实施募集资金投资项目的实施进度,或募集资金投资项目未能实现预期效益,或募集资金投资项目实施后,公司面临市场环境发生重大不利变化等情形,公司本次募集资金投资项目可能存在不能实现预期效益的风险。

(九)本次募集资金投资项目新增固定资产折旧对公司经营业绩影响的风险

本次募集资金投资于晶圆测试产能扩充项目、封测产能扩充项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目,项目实施后,公司固定资产规模将有较大幅度增加,公司未来经营业绩将面临固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。

(十)公司实际控制人控制权稳定性风险

公司实际控制人为公司董事长、总经理王成先生,王成先生通过直接持有公司股份、担任公司董事、总经理、通过成都芯动微电子科技有限公司、合肥芯动微电子科技有限公司、合肥芯动微电子科技有限公司、合肥